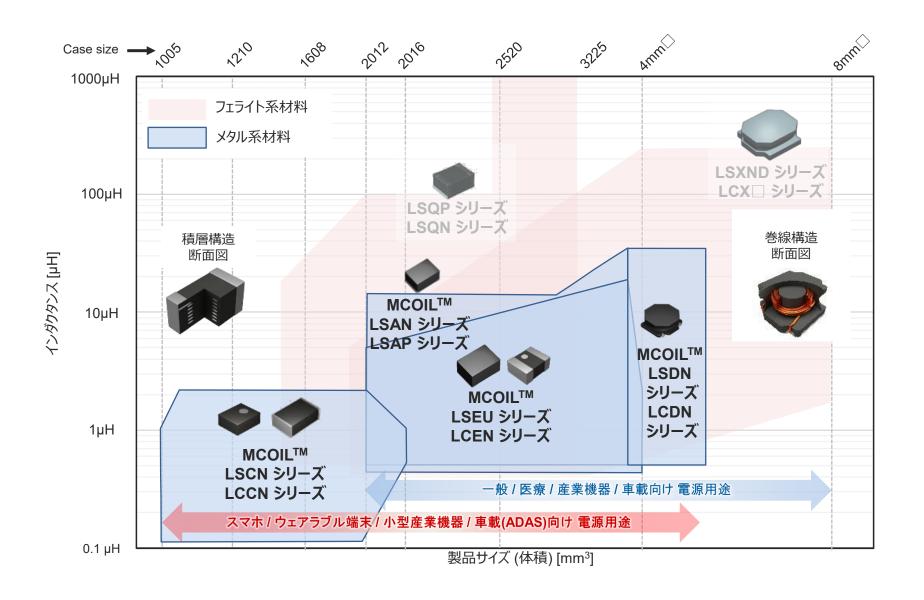
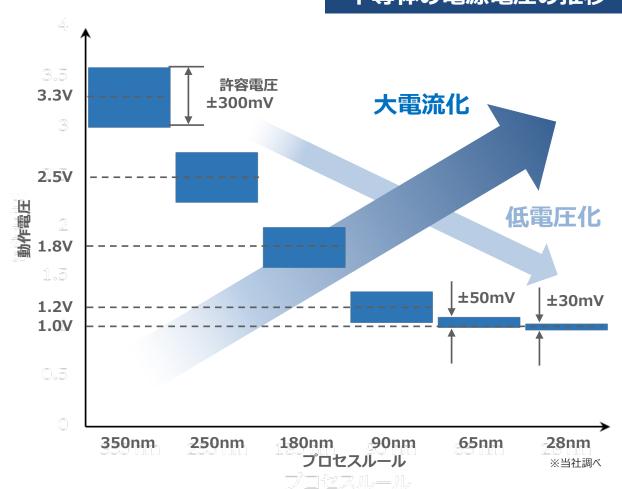
TAIYO YUDEN MCOIL™ シリーズ

TAIYO YUDEN ラインナップ



パワーインダクタのトレンド

半導体の電源電圧の推移



半導体プロセスルールの微細化

小型・多機能・高性能化

半導体を支える電源は 低電圧・大電流化が進む

パワーインダクタは **小型・大電流・高効率対応**へ

課題・現状からの解決策

課題

高性能・コンパクトな電子デバイスがトレンド パワーインダクタ ⇒小型・大電流・高効率が求められる

現状 小型にすると L値・Isatが不足 大電流にすると ・サイズアップしてしまう ・ランドパターンの変更が発生 高効率にすると 損失が小さいほどサイズが大きくなる

解決方法 最新のデバイストレンドに対応した太陽 誘電のパワーインダクタに変更! 小型 大電流 低抵抗 低コアロス

Solution



小型化/省エネに貢献する

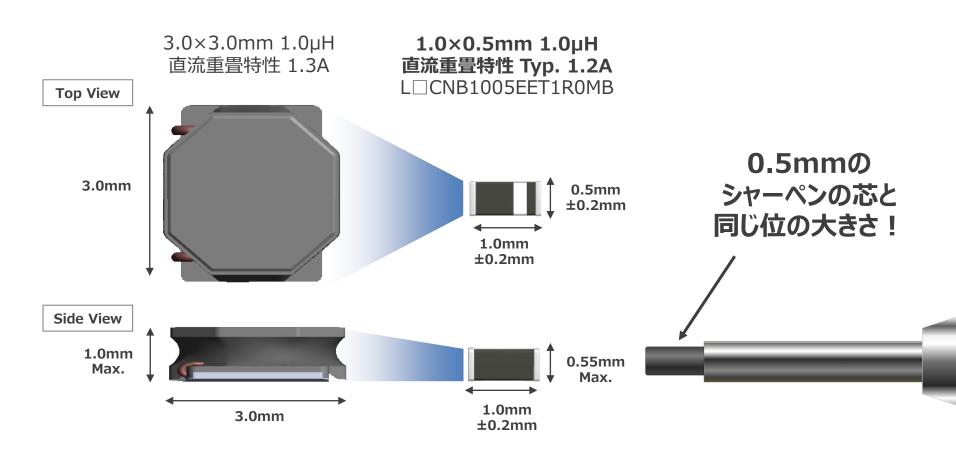
超小形状

メタル系パワーインダクタ

形状 **1005サイズ** インダクタンス **1.0**µH 直流重畳特性 **1.0**A

フェライト系パワーインダクタに対し、

同等特性で 面積ダウン -95% 体積ダウン -97% ※

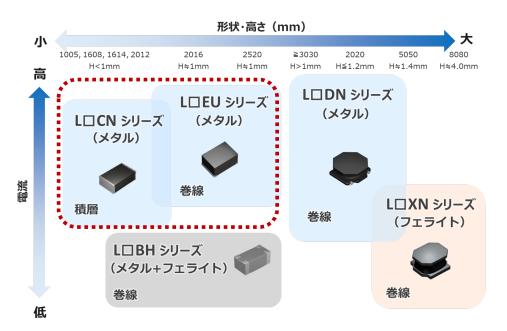


メタル系パワーインダクタ L□CN(積層)/L□EU(巻線) Series

世界で初めてメタル材料と積層構造(工法)を組み合わせた高性能・小型化を実現した L□CNシリーズと、巻線構造(工法)でメタル材料を改良し、大電流、低抵抗を実現した L□EUシリーズです。







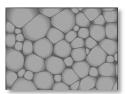
アプリケーション

スマートフォン / 車載 / 産業 / メモリ / パソコン

MCOIL™ シリーズ — 積層メタル系パワーインダクタ

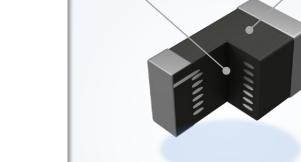
LSCN(MC) シリーズ

独自材料



酸化膜による 粒子結合

高耐熱性 高熱伝導性 低損失鉄系 磁性材料



プロセス特長

積層技術 **熱処理**技術

アプリケーション

スマートフォン/ウェアラブル IoT/車載/産業

Point

低抵抗

53%

小型化

参56%

大電流

%**3.0**倍

※インダクタンス値が同一のフェライト製品との比較

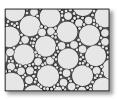
(ferrite products) Case Size(mm):2.0x1.25x1.0 Inductance:0.47uH Isat(max):1.2A Rdc(max):0.080Ω

·LSCND1412FETR47ME (metal products) Case Size(mm):1.4x1.2x0.65 Inductance:0.47uH Isat(max):3.6A Rdc(max):0.038Ω

MCOIL™ シリーズ — 巻線メタル系パワーインダクタ

LSEU(ME) シリーズ

独自材料



高充填

低損失 鉄系 磁性材料



プロセス特長

"独自の成型テクノロジー" +

> 高性能 磁性金属樹脂

アプリケーション

スマートフォン/車載 産業/メモリ/パソコン

Point

低抵抗

51%

低コアロス

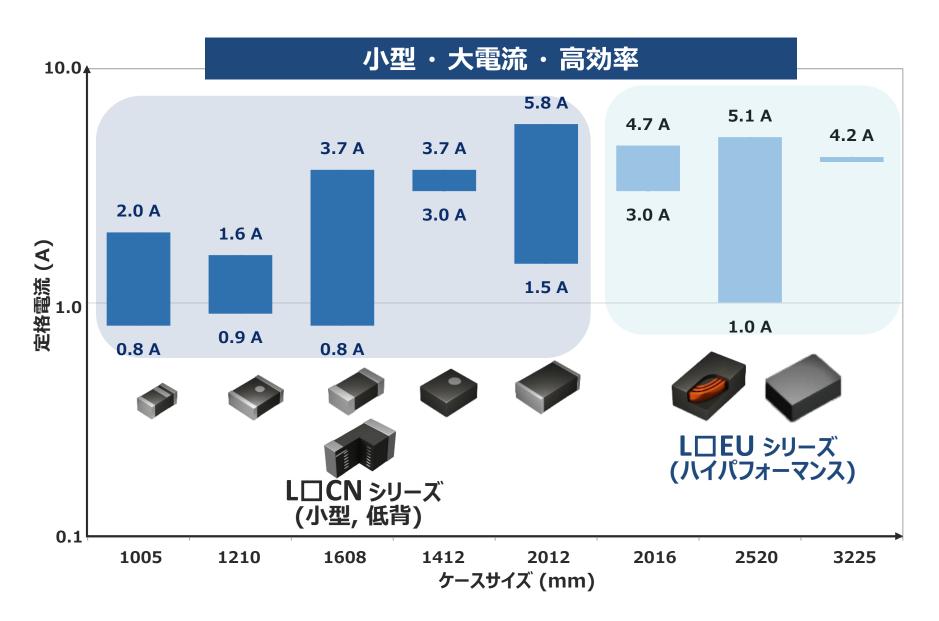
20%

大電流

A X H H H

※ インダクタンス値が同一のメタル製品との比較

- ·LSANB2520KKT2R2M (MA) Case Size(mm):2.5x2.0x1.0 Inductance:2.2uH Isat(max):1.5A Rdc(max):0.156Ω
- ·LSEUC2520KKT2R2M (ME) Case Size(mm):2.5x2.0x1.0 Inductance:2.2uH Isat(max):2.5A Rdc(max):0.076Ω



TAIYO YUDEN